

Title (en)

Alcaline cyanide baths for electroplating copper-tin alloys coatings.

Title (de)

Cyanidisch-alkalische Bäder zur galvanischen Abscheidung von Kupfer-Zinn-Legierungsüberzügen.

Title (fr)

Bains alcalins cyanurés pour le dépôt électrolytique de revêtements en alliage cuivre étain.

Publication

**EP 0636713 A2 19950201 (DE)**

Application

**EP 94109336 A 19940617**

Priority

DE 4324995 A 19930726

Abstract (en)

To produce bright to glossy, planarised copper-tin alloy coatings, electroplating baths are used which contain from 1 to 60 g/l of copper as copper cyanide, from 1 to 50 g/l of tin as alkali metal stannate, from 0 to 10 g/l of zinc as zinc cyanide, from 1 to 100 g/l of free alkali metal cyanide, from 1 to 50 g/l of free alkali metal hydroxide and, as a complexing agent, from 1 to 200 g/l of oligosaccharides and/or polysaccharides as well as, additionally, from 0.01 to 4 g/l of alkene sulphonate, alkine sulphonate, pyridine compounds or sulphur-containing propane sulphonates as a brightener.

Abstract (de)

Zur Herstellung blanker bis glänzender, eingeebener Kupfer-Zinn-Legierungsüberzüge verwendet man galvanische Bäder, die 1 bis 60 g/l Kupfer als Kupfercyanid, 1 bis 50 g/l Zinn als Alkalistannat, 0 bis 10 g/l Zink als Zinkcyanid, 1 bis 100 g/l freies Alkalizyanid, 1 bis 50 g/l freies Alkalihydroxid und als Komplexbildner 1 bis 200 g/l Oligosaccharide und/oder Polysaccharide enthalten und zusätzlich noch 0,01 bis 4 g/l Alkensäulfonat, Alkensäulfonat, Pyridinverbindungen oder schwefelhaltige Propansulfonate als Glanzmittel.

IPC 1-7

**C25D 3/58**; **C25D 3/60**

IPC 8 full level

**C25D 3/58** (2006.01); **C25D 3/60** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 3/58** (2013.01 - EP US); **C25D 3/60** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE102009041250A1; EP2085502A1; EP1961840A1; DE102009041250B4; EP2116634A1; WO2015000010A1; WO2015039152A1; DE102008032398A1; DE102008050135A1; WO2011029507A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 0636713 A2 19950201**; **EP 0636713 A3 19950726**; BR 9402931 A 19950411; DE 4324995 A1 19950202; DE 4324995 C2 19951221; JP 3305504 B2 20020722; JP H0754187 A 19950228; US 5534129 A 19960709

DOCDB simple family (application)

**EP 94109336 A 19940617**; BR 9402931 A 19940725; DE 4324995 A 19930726; JP 17424894 A 19940726; US 27763194 A 19940720